



## **Brief zum Jahreswechsel**

Ilmenau, Dezember 2008

Liebe IMAPS-Mitglieder,

auch 2008 ist die Zeit wieder wie im Fluge vergangen. An dieser Stelle möchte ich über die vergangenen 12 Monate Bilanz ziehen.

Die Mitgliederzahl konnte in diesem Jahr leicht ausgebaut werden, so dass wir etwas mehr als dreihundert Privat- und Firmenmitglieder (Stand Oktober) im Verband haben. Unser Angebot, Firmenprofile der Mitgliedsfirmen in der *PLUS* zu veröffentlichen und danach auf die Webseite zu stellen, halten wir auch in Zukunft aufrecht und bitten an dieser Stelle um weiteres Zuarbeiten.

Darüber hinaus liegt uns die Gewinnung junger Mitglieder sehr am Herzen. Einerseits können diese vom Erfahrungsschatz des *IMAPS*-Netzwerkes profitieren, andererseits bringen sie frische Fragestellungen aus einer Perspektive ein, die noch nicht vorgefestigt ist. Hier können alle gestandenen *IMAPS*-Mitglieder einen aktiven Beitrag leisten und potenzielle Neumitglieder über die Arbeitsweise und den familiären Charme von *IMAPS* informieren.

### **Veranstaltungen**

Das Frühjahrsseminar fiel in diesem Jahr zu Gunsten der *Ceramic Interconnect Ceramic Microsystems Technology Conference (CICMT)*, die erstmalig in Deutschland gastierte, aus. Vom 21. bis zum 24. April luden *IMAPS Deutschland*, *IMAPS North America*, die *Deutsche Keramische Gesellschaft (DKG)* und die *American Ceramics Society (ACerS)* nach München. Mit 245 Teilnehmern konnte sogar ein neuer Besucherrekord aufgestellt werden. Für den Erfolg der Veranstaltung, die auch mit einem deutlichen finanziellen Plus aufwarten konnte, waren neben dem Organisationskomitee insbesondere die zahlreichen Aussteller sowie das Veranstaltungsmanagement vor Ort verantwortlich. Vielen Teilnehmern bleibt diese Konferenz in sehr guter Erinnerung.

Die Herbstkonferenz mit Mitgliederversammlung fand erstmalig an der *Hochschule München* statt. Mit der Änderung des Konferenzortes konnte auch der Zeitraum auf Dienstag/Mittwoch in der Folgewoche nach der *SEMICON Europe* verschoben werden. Auch zu dieser Veranstaltung konnten wir ein überaus positives Resümee ziehen; erstmalig nach mehreren Jahren hatten wir wieder mehr als einhundert Teilnehmer, und 17 Aussteller nutzten die Gelegenheit, sich vorzustellen. Unsere Gastgeber an der *Hochschule München* überzeugten durch ausgezeichnete Rahmenbedingungen. Wir haben bereits die Zusage, dass wir auch im nächsten Jahr an der Hochschule willkommen sind.

Im kommenden Jahr wird neben dem Seminar zum Thema *Zuverlässigkeit* (an der *TU Ilmenau*, 17. März) und der Konferenz (13./14. Oktober) auch wieder eine europäische *IMAPS*-Tagung stattfinden (14./17. Juni). Der Call for Papers für die *EMPC* in Rimini ist noch bis zum Ende Dezember offen. Diese Konferenz wird ebenfalls durch eine Ausstellung begleitet.

### **Änderungen im Vorstand und Ausblick auf 2009**

Bei der Wahl des Vorstands während der ordentlichen Mitgliederversammlung wurden *Dr. Gisela Dittmar* in der Funktion der 2. Vorsitzenden und *Hans-Ulrich Knipps* als Schatzmeister bestätigt.

Im erweiterten Vorstand wird *Paradiso Coskina*, die zurzeit im Erziehungsurlaub ist, durch ihren Kollegen *Lutz-Günter John (VDI/VDE-IT)* seit Juni 2008 vertreten. *Lutz-Günter John* wechselt sich mit den beiden anderen Redakteuren *Dr. Karl-Heinz Drüe* und *Thomas Bartnitzek* bei der monatlichen Erstellung der redaktionellen Beiträge für die *IMAPS-*

Mitteilungen in der *PLUS* ab. Dr. Martin Oppermann, der in der Vergangenheit als Schnittstelle zum *IMAPS*-Mitgliederjournal *Advancing Microelectronics* fungierte, bat den Vorstand aufgrund seiner hohen beruflichen Belastung um Entlastung von dieser Tätigkeit. Für diese Position konnte kurz nach der Mitgliederversammlung Dr. Markus Detert von der *TU Dresden* gewonnen werden.

Wie viele andere kann auch ich persönlich auf ein sehr erfolg- und arbeitsreiches Jahr 2008 zurückblicken. Durch meine neue Tätigkeit als Universitätslehrer und die damit verbundenen Pflichten bei der Weiterentwicklung des Fachgebiets verbleibt allerdings weniger Zeit für die *IMAPS*-Tätigkeiten. Damit wuchs die innere Unzufriedenheit, die Arbeit für *IMAPS* nicht mehr gemäß dem eigenen Qualitätsanspruch zu leisten. Ich habe mich deshalb entschlossen, bei der kommenden Wahl des 1. Vorsitzenden im Oktober 2009 nicht mehr zu kandidieren. Dies soll jedoch nicht bedeuten, dass ich mich komplett aus der aktiven *IMAPS*-Arbeit zurückziehen möchte. Ich hoffe auf Ihr Verständnis zu dieser Entscheidung.

Im Namen des gesamten Vorstands der *IMAPS Deutschland* wünsche ich Ihnen und Ihren Familien Gesundheit sowie Erfolg im privaten und beruflichen Alltag im Jahr 2009. Ich hoffe, dass die gegenwärtige Finanzkrise nicht jene trifft, die wirkliche Werte produzieren und würde mich freuen, Sie zahlreich bei den *IMAPS*-Veranstaltungen in Deutschland und in Rimini zu begrüßen.

gez.

Prof. Dr.-Ing. Jens Müller

Vorsitzender *IMAPS Deutschland e.V.*

## Nachlese zur deutschen *IMAPS*-Konferenz 2008 in München

Die diesjährige *IMAPS*-Konferenz fand am 14. und 15. Oktober in der *Hochschule München* statt. Da die Konferenz um 13 Uhr eröffnet wurde, konnten alle Teilnehmer entspannt anreisen. Der freie Vormittag kam natürlich auch den Ausstellern für den Standaufbau zugute.

Die *Hochschule München* präsentierte sich als guter Gastgeber für die über 100 Teilnehmer und 17 Aussteller. Sowohl der Hörsaal als auch die Flächen für die Aussteller und Pausenversorgung ermöglichten einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung.



Entspannte Pausengespräche mit den Ausstellern



Gespannte Aufmerksamkeit im Hörsaal



Der neue Gastgeber stellte ausreichend Platz für Aussteller und Pausenversorgung



Referenten des wissenschaftlichen Konferenzprogramms



Ansprache von Frau Modes von W. C. Heraeus bei der traditionellen Abendveranstaltung im Augustiner

Das wissenschaftliche Konferenzprogramm umfasste insgesamt 18 Vorträge. Das Spektrum reichte von der Dickfilmtechnik, LTCC-Funktionswerkstoffen, optoelektronischen Neigungssensoren, der Vorstellung eines abgestimmten Stressmesssystems für verpackungsbedingten Stresseintrag, der Zuverlässigkeit von Packages für die Raumfahrt, einer prozessintegrierten Qualitätskontrollmethode beim Drahtbonden bis hin zu aktuellen Trends in der Dünnfilmtechnik. Der Best Paper Award wurde dieses Jahr an *Alexander Ferber* von der *AEMtec GmbH* aus Berlin für den Vortrag *Mischbestückung von COB und SMD – AVT in der industriellen Praxis* vergeben.

Wie gewohnt fand am Dienstagnachmittag im Anschluss an den ersten Teil der Konferenz die jährliche Mitgliederversammlung von *IMAPS Deutschland* statt. In dem Rechenschaftsbericht vom 1. Vorsitzenden *Jens Müller* wurde ein Überblick über die vielfältigen nationalen und internationalen Aktivitäten des Vereins gegeben. Im Anschluss daran gab der Schatzmeister *Hans-Ulrich Knipps* einen Überblick über die Einnahmen- und Ausgabensituation sowie den Veränderungen des Mitgliederstandes des Vereins. Der Schatzmeister konnte aufgrund erfolgreich durchgeführter Veranstaltungen und einer leicht angestiegenen Mitgliederzahl von einer soliden Finanzsituation berichten. Aufgrund der guten Vereinsarbeit gab es von den Anwesenden nur Zustimmung für die Arbeit des Vorstandes. Damit konnte der Vorstand entlastet werden. Unter dem erfahrenen Wahlleiter *Heinz Osterwinter* wurde der neue Vorstand gewählt. Es gab zum Vorschlag der

Wahlkommission keinen Gegenkandidaten und so wurde *Jens Müller* wieder zum 1. Vorsitzenden, *Gisela Dittmar* wieder zur 2. Vorsitzenden und *Hans-Ulrich Knipps* wieder zum Schatzmeister von den 47 Teilnehmern ohne Gegenstimmen gewählt.

Nach einer kurzen Pause ging es zur traditionellen Abendveranstaltung in den *Augustiner*. Hier gab es Gelegenheit, den vielen Sponsoren der Konferenz und der Abendveranstaltung zu danken. *Frau Modes* von *W. C. Heraeus GmbH* – ebenfalls Sponsor der *IMAPS*-Veranstaltung – nahm anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Bereiches Dickfilm die Gelegenheit beim Schopf und wies auf dessen erfolgreichen Forschungs- und Investitionsanstrengungen der letzten Jahrzehnte hin. Neben dem richtigen Gespür für Technologie- und Markttrends waren auch die aktive Unterstützung von neuen Materialentwicklungen für die Aufbau- und Verbindungstechnik mit für den Erfolg dieses Bereiches verantwortlich. Die abendlichen Redner spazierten natürlich mit Blick auf das Büfett die Teilnehmer nicht zu lange, so dass sowohl das ausgiebige und schmackhafte Büfett als auch die traditionellen bayerischen Getränke einer angeregten Diskussion förderlich werden konnten.

Sowohl die Konferenz als auch die Abendveranstaltung werden sicherlich allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben. Über einzelne Beiträge wird es noch in den folgenden Ausgaben der *PLUS* Gelegenheit geben ausführlicher zu berichten.

## Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Ilmenau	17.3.2009	IMAPS-Frühjahrsseminar	IMAPS Deutschland
Denver/Co.	20./23.4.2009	5 <sup>th</sup> CICMT	IMAPS & ACeRS
Rimini	14./17.6.2009	EMPC 2009	IMAPS Europe

## 1<sup>st</sup> Call for papers

ISSE 2009

### 32<sup>nd</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology

Hetero System Integration, the path to New Solutions in the Modern Electronics

Dear Colleagues,

We are pleased to invite you to submit a paper/abstract to the 32<sup>nd</sup> International Spring Seminar on Electronics Technology. It will take place in the centre of the Europe, in beautiful city Brno, Czech Republic, on **May 13<sup>th</sup>/17<sup>th</sup>, 2009**.

#### Important Dates:

Submission of Abstracts:	February 13 <sup>th</sup> , 2009
Notification of acceptance:	March 13 <sup>th</sup> , 2009
Registration of authors and participants for reduced price:	March 31 <sup>st</sup> , 2009
Submission of Camera-ready papers and authors' registration:	April 17 <sup>th</sup> , 2009

The *International Spring Seminar on Electronics Technology* is the premier European forum for the exchange of information between senior and young scientists from academic communities and electronic industries from around the world on topics related to their experimental and theoretical work in the very wide-spread field of electronics and microelectronics technology and packaging.

Based on a unique combination of oral and poster presentations as well as individual meetings, professors and students, senior and junior researchers can come together to discuss scientific and educational topics and organize international cooperation in a convenient atmosphere during four conference days. It is our pleasure to encourage you to participate in ISSE 2009, organized by *Brno University of Technology* in the hearth of Europe.

#### ISSE 2009 Conference Committee:

General Chair:	<i>Klaus-Jürgen Wolter</i> , ISSE SC Chair, TU-Dresden, Germany
Conference Chair:	<i>Ivan Szendiuch</i> , BUT Brno, Czech Republic
Conference Co-Chair:	<i>Vladislav Musil</i> , BUT Brno, Czech Republic

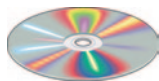
#### Topics Of Interest

- A. Innovations in Film Technologies and LTCC
- B. Advanced Packaging and Interconnection Technologies
- C. Thermal Characterization, Reliability and Quality
- D. System Modelling and Simulation
- E. Bio Electronics, Environmental and Ecology in Electronics Technology
- F. Nanotechnology, Nanomaterials and Nanoelectronics
- G. New Materials and Processes
- H. Educational and Information Activities in Electronics Technology

Weitere Informationen unter <http://isse2009.org>

#### Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings der Münchner *IMAPS-Herbsttagung* vom 14./15. Oktober 2008 können auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papierausdruck zum Preis von



€110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2007* in München und des Seminars 2007 in Ilmenau sind noch erhältlich.

Ebenfalls sind die Unterlagen der *Deutschen IMAPS-Seminare 2006 und 2007* zu den Themen *Muss jeder Sensor smart sein?* (Februar 2006 in Göppingen) und *Flip Chip – die Alternative zum Drahtbonden?* (Februar 2007 in Ilmenau) noch erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vättmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, [hans-ulrich.knipps@imaps.de](mailto:hans-ulrich.knipps@imaps.de)

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

## Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die neu gestalteten Webseiten von *IMAPS Deutschland* im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft

beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von *IMAPS* erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

## Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Jens Müller

[jens.mueller@imaps.de](mailto:jens.mueller@imaps.de)

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

[hans-ulrich.knipps@imaps.de](mailto:hans-ulrich.knipps@imaps.de)

Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern findet man unter [www.imaps.de](http://www.imaps.de) (*Vorstand*)

## Erfassung von Lötprofilen

### Methodik, Fehlerquellen, Messtoleranzen

Von Prof. Dr. Armin Rahn. Erste Auflage 2008. 112 Seiten.

ISBN 978-3-87480-250-5. Preis € 58,- inkl. 7 % MwSt., zuzüglich Porto

Der Übergang von der bleihaltigen zur bleifreien Löttechnik in der Elektronik hat eine Reihe von Fragen aufgeworfen, mit denen sich alle in die Prozesskette involvierten Stellen auseinandersetzen müssen. Das beginnt beim Bauteilhersteller und dem Leiterplattendesigner, betrifft den Produzenten von Lot, Paste und Flussmittel, beeinflusst Design und Qualität der Lötanlage, erfordert angepasste Temperaturmessmethoden zur Prozesssicherung und Optimierung des Temperaturprofils der Lötanlage und hat Auswirkungen auf die Reparatur- bzw. Nachlötplätze.

Diesen komplexen Themenkreis behandelt Prof. Dr. Armin Rahn in seinem neuen Buch, in dem er wissenschaftlich fundierte und sehr konkrete Hinweise und Ratschläge für die Arbeit in der Produktion gibt. Großer Platz wird den versteckten Fehlerquellen und den praktisch anwendbaren Temperaturmessmethoden eingeräumt.

Dieses Werk dürfte sich schon dann vielfach bezahlt machen, wenn nur eine einzige zusätzliche fehlerfreie Baugruppenserie die Lötanlage verlässt.

## Eugen G. Leuze Verlag KG

Karlstraße 4 · D-88348 Bad Saulgau · Tel. 07581/4801-0 · Fax 07581/4801-10

[brigitte.brotzer@leuze-verlag.de](mailto:brigitte.brotzer@leuze-verlag.de) · [www.leuze-verlag.de](http://www.leuze-verlag.de)